



中国北京

ICICM2019

2019年10月25-27日

投稿截止日期: 8月30日



icicm@young.ac.cn
http://www.icicm.net/



+86-28-87777577



北京和乔丽致酒店
北京市朝阳区光华路甲8号

会议简介

第四届集成电路与微系统国际会议将于2019年10月25-27日在北京召开! 本次会议由IEEE(电气和电子工程师协会), 电子科技大学微电子与固体电子学会, 东南大学联合承办, 欢迎广大专家学者踊跃投稿, 积极参会!

ICICM 2016论文集已经成功入库IEEE Xplore, 并被CPCI, Ei 和Scopus检索!

ICICM 2017论文集已经成功入库IEEE Xplore, 并被Ei 和Scopus 检索!

ICICM 2018论文集已经成功入库IEEE Xplore, 并被Ei 和Scopus 检索!

大会主讲

★主旨报告

Ljiljana Trajkovic教授, IEEE Fellow, 加拿大西蒙弗雷泽大学

Fei Yuan教授, 加拿大瑞尔森大学

邹卓教授, 中国复旦大学

★特邀报告

Sheng-Lyang Jang教授, 台湾科技大学

戴永胜教授, 中国南京科技大学

委员会表

★顾问主席

Ljiljana Trajkovic教授, IEEE Fellow,

加拿大西蒙弗雷泽大学

★大会主席

王志功教授, 中国东南大学

李强教授, 中国电子科技大学

詹景裕教授, 台北大学

★程序委员会主席

Fei Yuan教授, 加拿大瑞尔森大学

邹卓教授, 中国复旦大学

刘大可教授, 中国北京理工大学 | 瑞典林雪平大学

Keping Wang副教授, 中国东南大学

★指导委员会主席

黄天乐教授, 中国电子科技大学

戴永胜教授, 中国南京科技大学

Sheng-Lyang Jang教授, 台湾科技大学

★审稿委员会

王晓晓教授, 中国北航大学

Jinyan Wang教授, 北京大学

Bo Yan教授, 中国电子科技大学

Ashutosh Kumar Singh教授, National Institute of

Technology, Kurukshetra, India

Hamed Alipour-Banaei教授, Islamic Azad University

Tiejun Chen教授, 中国益阳医学院

Changchun Zhang教授, 上海邮电大学 / 东南大学

Yu Bai助教, California State University Fullerton, USA

Jinzhao Wu教授, 广西民族大学

Dr. Yu Bi, University of Central Florida, USA

Dr. Wen Cheng Lai, 台湾科技大学

Shiwei Feng教授, 北京工业大学

Xingyuan Tong教授, 西安邮电大学

更多委员会成员请参见官网。

★技术支持



出版说明

本次会议收录的文章将作为IEEE会议论文集出版并被入库IEEE Xplore, 由Ei Compendex和Scopus检索。



征稿主题

★征稿主题包括但不限于以下内容:

THZ和微波微系统

无线系统的装置和电路

通信专用电路和系统

数字、模拟、混合信号IC和SOC设计技术

硅集成电路与制造

低功率、射频设备和电路

集成电路计算机辅助设计技术

硅锗器件与器件物理

互连、低K、高K等工艺技术

非常规和纳米电子学

有机半导体器件与技术

复合半导体器件和电路

显示器、传感器和MEMS

半导体材料与材料特性

包装检测技术

太阳能电池及其他新能源设备

建模与仿真

设备技术

可靠性

显示器、传感器和MEMS

高级存储技术 (闪存、FERAM、PCM、RERAM、MRAM等)



大会支持

★合办单位

